

**OMNIMATE Housing – serie CH20M
SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Naturligtvis är systemet CH20M överlägset i
detaljerna vid gränssnitten till periferin**

Stiftlistor och kontaktdon är lika välanpassade till den praktiska verkligheten som hela systemet vad det gäller utformningsalternativ, tillverkningskvalitet, bearbetning, manövrerbarhet, pålitlighet och säkerhet.

Anslutningstekniken får högsta betyg i alla grenar:

- **100 % säker mot förväxling** med "AutoSet"-kodning som inte kan förloras säkerställs en anordning av anslutningarna som är säker mot felanslutning.
- **100 % säker** genom tvåsidig fingersäkerhet på stiftlist och hylsdel
- **100 % effektiv** med reflow-kompabilitet på alla THR stiftlistor.

Allmänna beställningsdata

Typ	SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX
Art.nr.	1069760000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, Anslutningselement vänster, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (!): 5.9 mm, förtennad, svart, Box
GTIN (EAN)	4032248825196
Frp	120 Stück
Produktparametrar	IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning	Box

**OMNIMATE Housing – serie CH20M
SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	23,3 mm	Bygglängd (tum)	0,917 inch
Bredd	15,4 mm	Byggbredd (tum)	0,606 inch
Höjd	14,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,567 inch
Nettovikt	2,725 g		

Systemparametrar

Produktfamilj	OMNIMATE Housing – serie CH20M	Anslutningstyp	Kretskortanslutning
Montering på kretskortet	THT/THR lödanslutning	Delning i mm (P)	5 mm
Delning i tum (P)	0,197 inch	Anslutningsvinkel	90°
Antal poler	3	Antal lödstift per pol	1
Lödstiftlängd (l)	5,9 mm	Tolerans för stiftlängd	+0,1 / -0,3 mm
Tolerans för lödstiftsposition	± 0,1 mm	L1 i mm	10 mm
L1 i tum	0,394 inch	Antal rader	1
Polradstal	1	Koderbar	Ja
Stickcykler	25		

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	IIla
CTI	≥ 175	Isolationshållfasthet	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Kontaktyta	förtennad
Lagertemperatur, min.	-25 °C	Lagertemperatur, max.	55 °C
relativ fuktighet vid lagring, max	80 %	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur, max	120 °C	Temperaturområde Montage, min.	-30 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA)



Certifikat nr. (CSA)

200039-70153051

Märkspänning (användargrupp B / CSA)	300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA)	300 V
Märkström (användargrupp C / CSA)	9 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 26
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkspänning (användargrupp C / CSA)	50 V
Märkström (användargrupp B / CSA)	9 A
Märkström (användargrupp D / CSA)	9 A
Ledardiameter AWG, max.	AWG 12

**OMNIMATE Housing – serie CH20M
SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Märkdata enligt UL 1059**

Institut (cURus)



Certifikat nr (cURus)

E60693

Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)	50 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	300 V	Märkström (användargrupp B / UL 1059)	9 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)	9 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	9 A
Ledardiameter AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter AWG, max.	AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	10 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	9 A	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2	400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2	320 V	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3	250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2	4 kV	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2	4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3	4 kV		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02	eClass 8.1	27-44-04-02
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Anmärkningar

Anmärkningar

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

OMNIMATE Housing – serie CH20M SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[CSA Certificate of Compliance](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

**OMNIMATE Housing – serie CH20M
SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

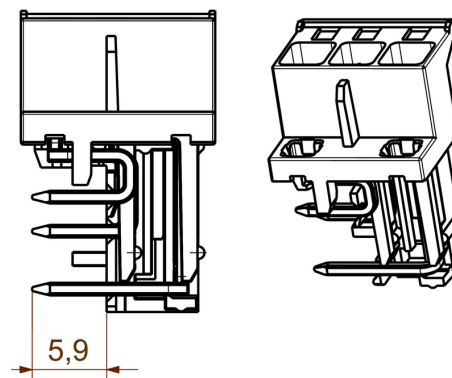
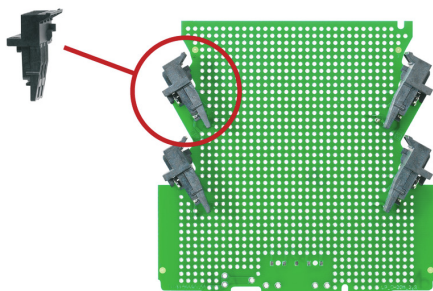
Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**

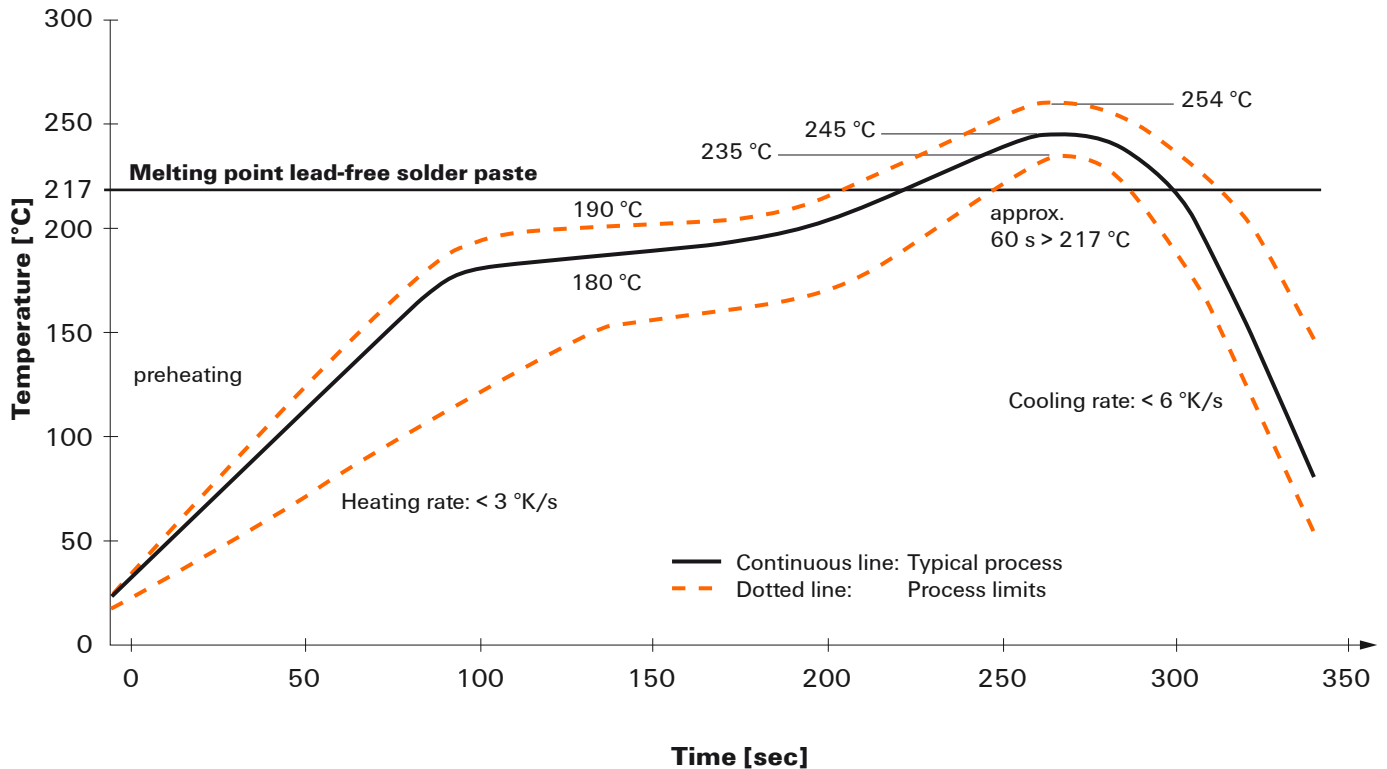
for left side



delivery

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

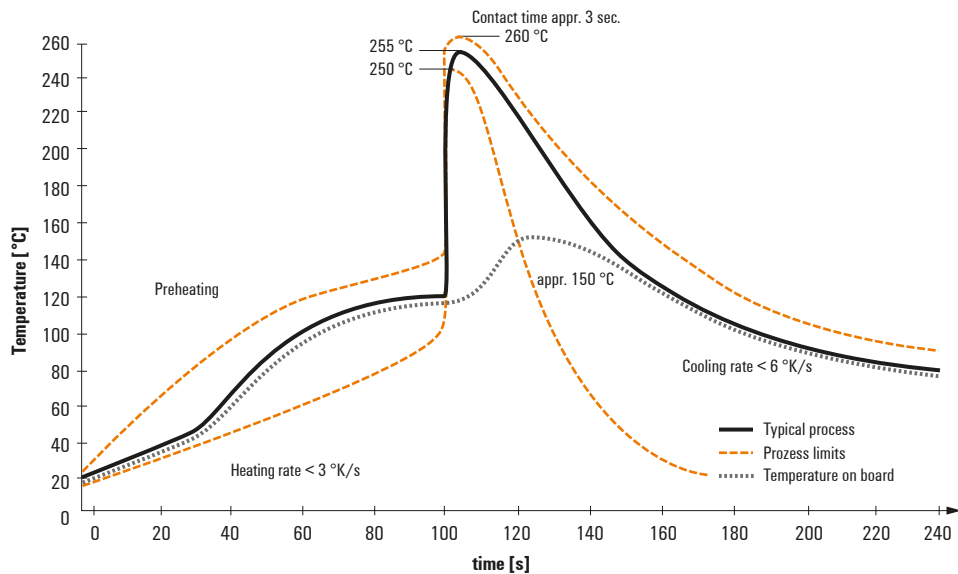
- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

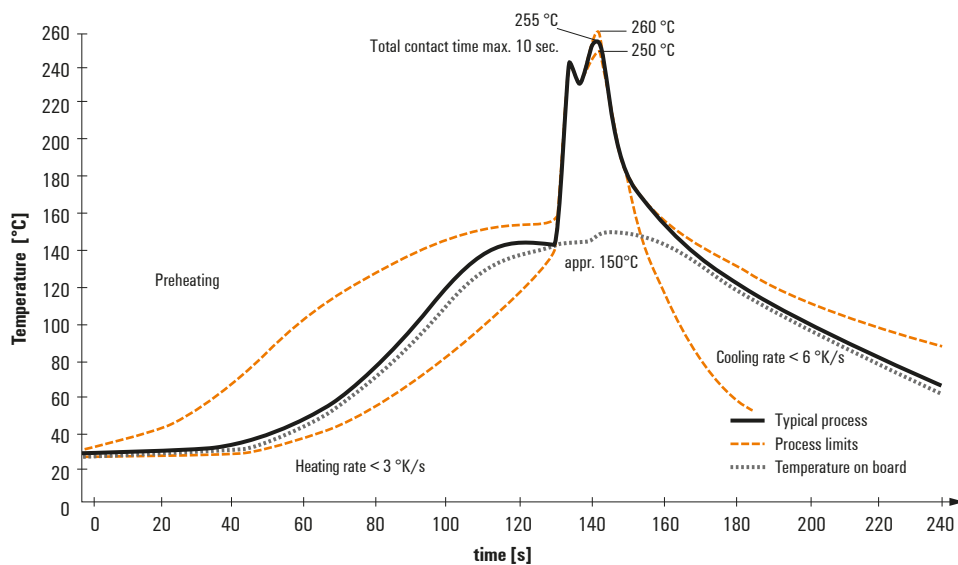
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

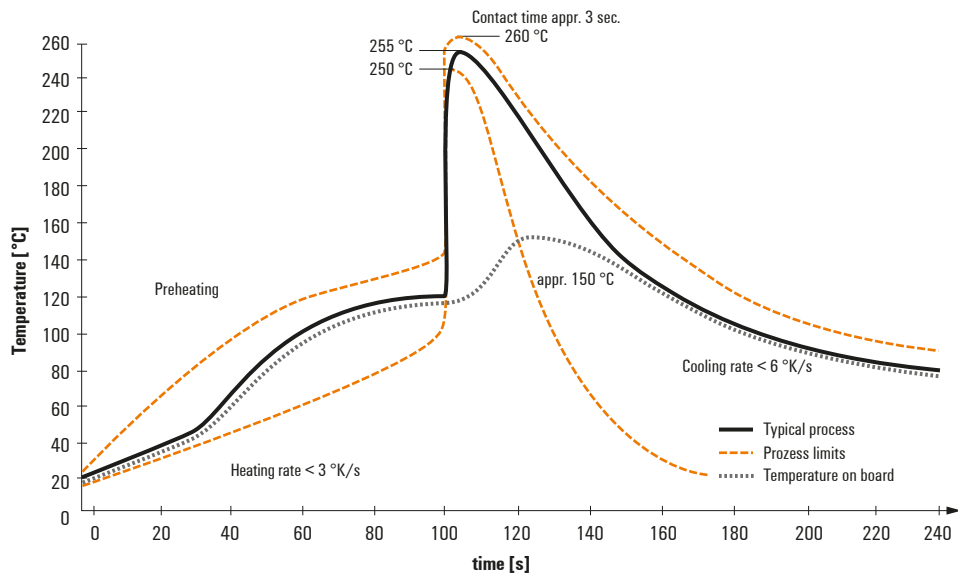
The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

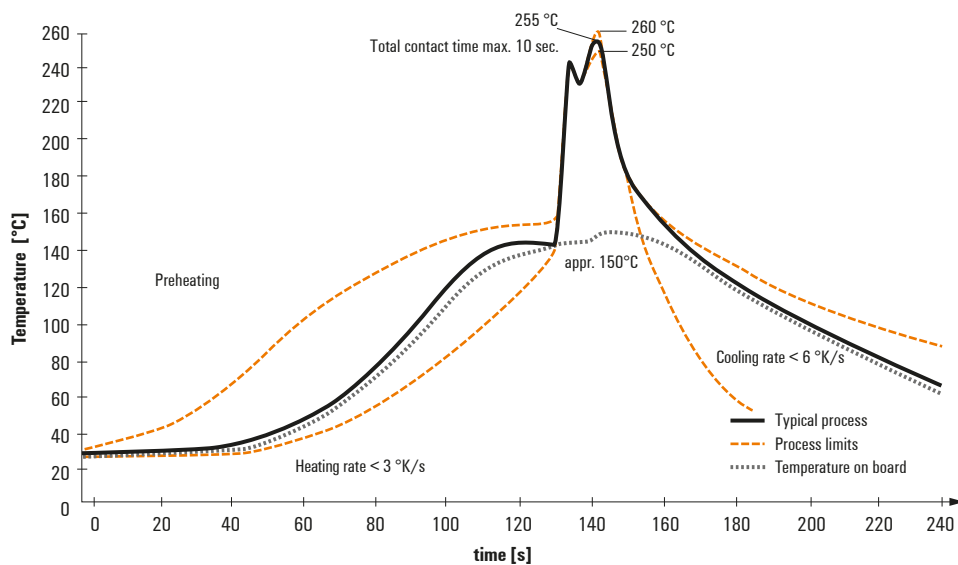
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

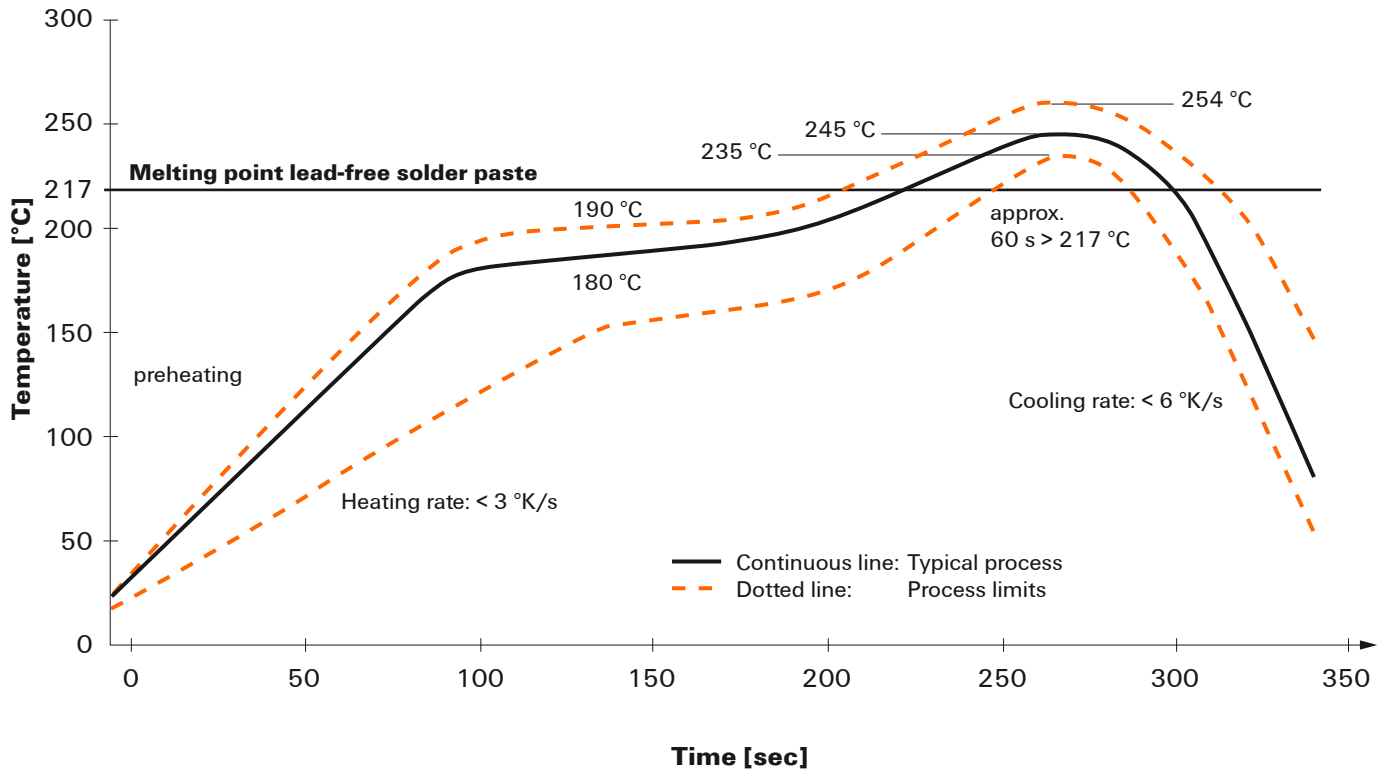
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.